



**한미반도체**

**기업가치 제고 계획**

2025년 12월

# Disclaimer

본 자료는 한미반도체 주주 및 투자자 등 이해관계자 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 본 자료에 기재된 내용 중에는 회계감사 처리되지 않은 재무정보가 포함되어 있습니다. 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

회사는 자료의 내용 완결성에 대해서 어떠한 진술 보장도 하지 않습니다. 또한, 당사의 사전 동의 없이 본 문서의 내용을 수정, 배포 및 복제할 수 없습니다.

본 자료는 한미반도체의 계획 및 이용 가능한 정보를 바탕으로 한 확정되지 않은 미래 재무 실적, 사업전망 등 예측 정보를 포함하고 있습니다. 향후 경영여건과 시장상황 변화에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며, 계획 사항은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료에 기재된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 제공 당시의 상황에 따라 해석되어야 합니다. 또한, 회사는 본 자료 제공 이후의 중대한 변화를 반영하도록 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며 당사는 본 자료 또는 본 자료에 포함된 정보를 이용함으로써 인해 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 손해에 대해서 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

# • Micron으로부터 ‘Top Supplier’ 수상

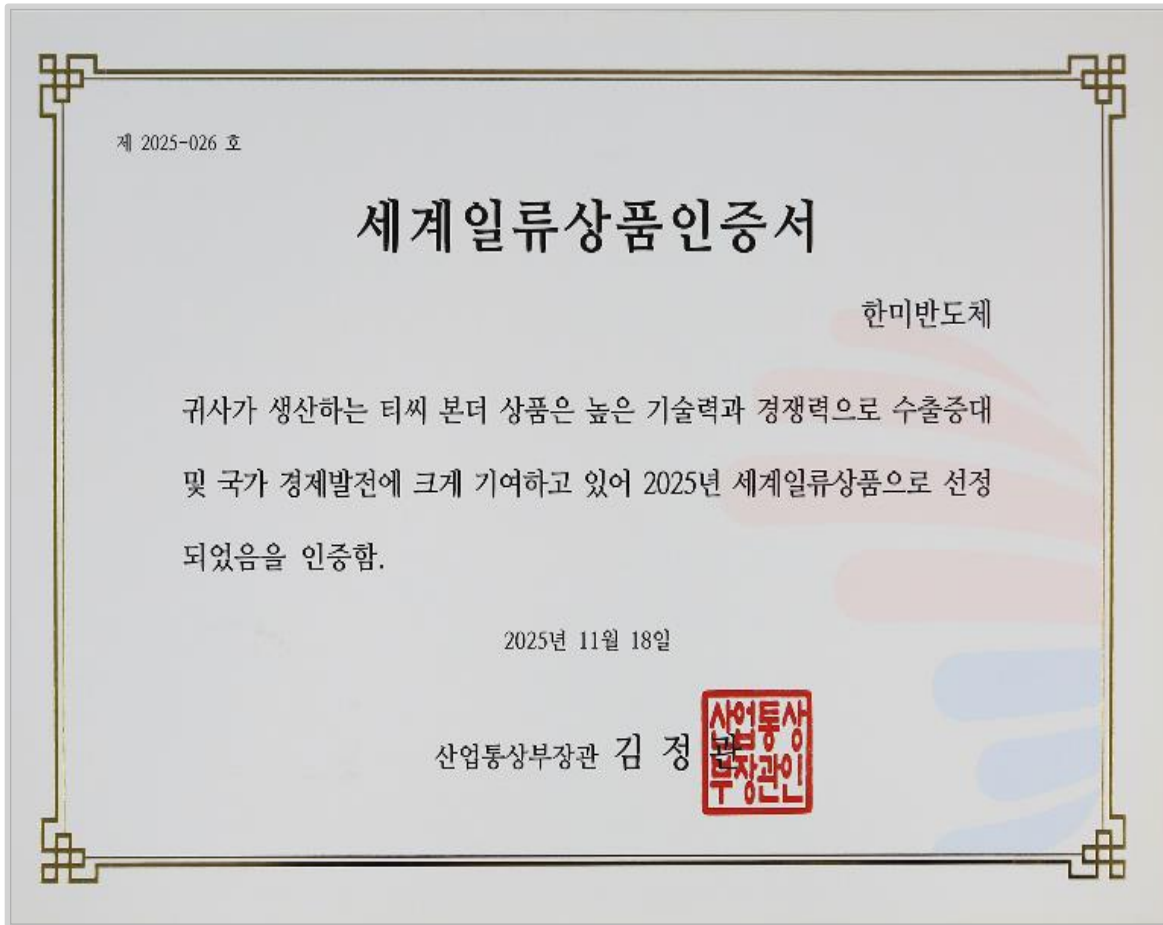
- 글로벌 반도체 장비 시장에서 최고 수준의 기술력과 품질 갖춰움을 입증
- 한미타이완, 한미싱가포르 현지 법인 설립을 통해 전문 엔지니어가 최상의 밀착 서비스 제공



- ✓ Micron으로부터  
**‘Top Supplier’ 수상**
- HBM 생산용 TC 본더 공급
- ✓ Micron은  
첨단 HBM 생산 공장 건설 중
- 싱가포르 우드랜드 공장  
→ 2027년 HBM 생산 시작
- 일본 히로시마 공장  
→ 2028년 HBM 생산 예정

# • TC 본더 세계일류상품 선정

- 산업통상부, 2025년 11월 18일 한미반도체 ‘TC 본더’ 세계일류상품으로 선정



## 차세대 HBM 공정 필수 장비 TC 본더 글로벌 리더

- HBM3e 기준 세계 시장 점유율 90% (2024년 기준)  
→ 현재, HBM 생산용 TC 본더 세계 1위
- HBM4 & HBM5용 TC 본더 시장 점유율 95% 목표
- TC NCF, hMR-MUF 두가지 타입의 TC 본더 생산

## Advanced Package Bonder 핵심 밸류체인 구축

- TC 본더 생산에 필요한 핵심 부품 밸류체인 공급사들과 우호적 파트너 관계 수립  
→ 핵심 부품의 안정적 공급과 품질 경쟁력 확보

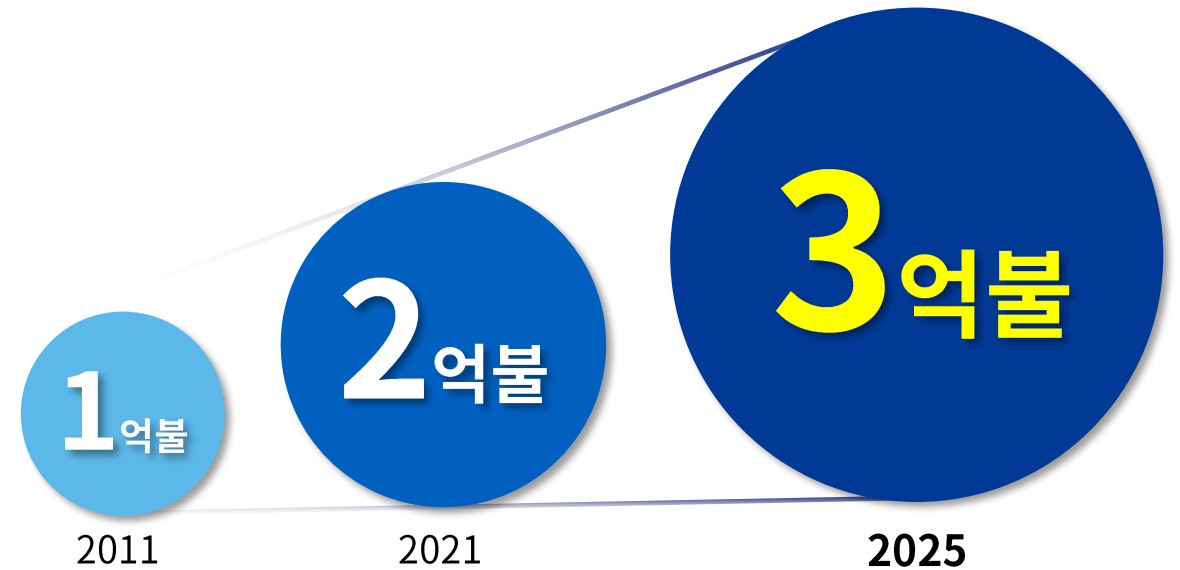
# • 3억불 수출의 탑 수상

- 과거 10년간 해외 매출 비중 평균 약 70% 기록
- 2025년 12월 4일 제 62회 ‘무역의 날’ 기념식에서 ‘3억불 수출의 탑’ 수상



## 한미반도체 수출탑 수상 내역

- 불과 4년만에 3억 달러까지 증가하며, 가파른 수출 성장 속도 입증



# • HBM TC 본더 세계 점유율 1위 선정

- 2025년 전세계 HBM 생산용 TC 본더 점유율 71.2% 기록
- 향후, 차세대 최첨단 HBM에서도 독보적인 지위 지속 전망

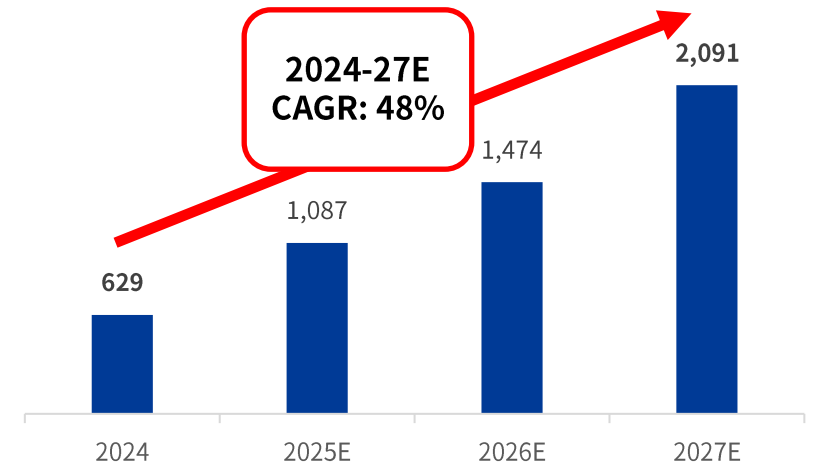
## 테크인사이트, 한미반도체 HBM TC 본더 세계 점유율 1위 선정

테크인사이트 HBM TC 본더 매출 · 시장 점유율

순위	기업	2024년		2025년 (3분기 누적)	
		매출 (\$M)	시장점유율	매출 (\$M)	시장점유율
1	HANMI Semiconductor	294.9	70.4%	247.7	71.2%
2	SEMES (세메스)	54.3	13.0%	45.5	13.1%
3	ASMPT	26.6	6.3%	19.5	5.6%
4	Yamaha Robotics (야마하 로보틱스)	39.3	9.4%	19.4	5.6%
5	Hanwha Semitech (한화세미텍)	0	0%	11.0	3.2%
6	Kulicke & Soffa (K&S)	2.8	0.7%	3.8	1.1%
7	BE Semiconductor Industries (BESI)	1.2	0.3%	1.1	0.3%
Total		419.1	100%	347.8	100%

Source: 테크인사이트 (2025년 12월)

## HBM 본더 시장규모 전망 (단위: 십억원)



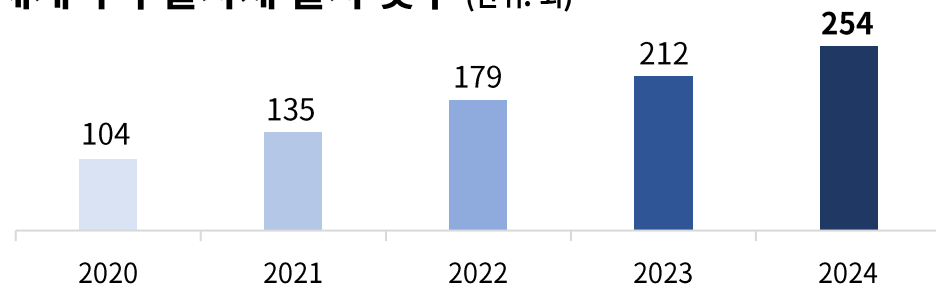
Source: Company data, J.P. Morgan Estimates.

**한미반도체, 첨단 HBM(12단 HBM3e) 생산용 TC 본더 글로벌 점유율 90% 이상 확보**

# 우주탐사용 로켓, 통신위성용 전자파 차폐장비 공급

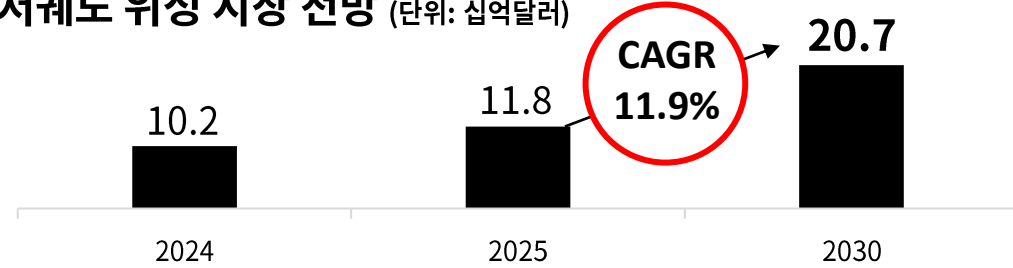
- 우주탐사용 로켓, 저궤도 위성통신(LEO), 방산용 드론, 그리고..  
스마트 기기용(휴대폰, 블루투스 이어폰, 스마트 워치) 위성문자 시스템 필수 장비
- 반도체 칩간 전자기파 노이즈로부터 반도체 칩을 보호하고 칩의 기능을 정상 작동시키는 장비

전세계 우주발사체 발사 횟수 (단위: 회)



Source: 군터스 스페이스 · 한국항공우주연구원

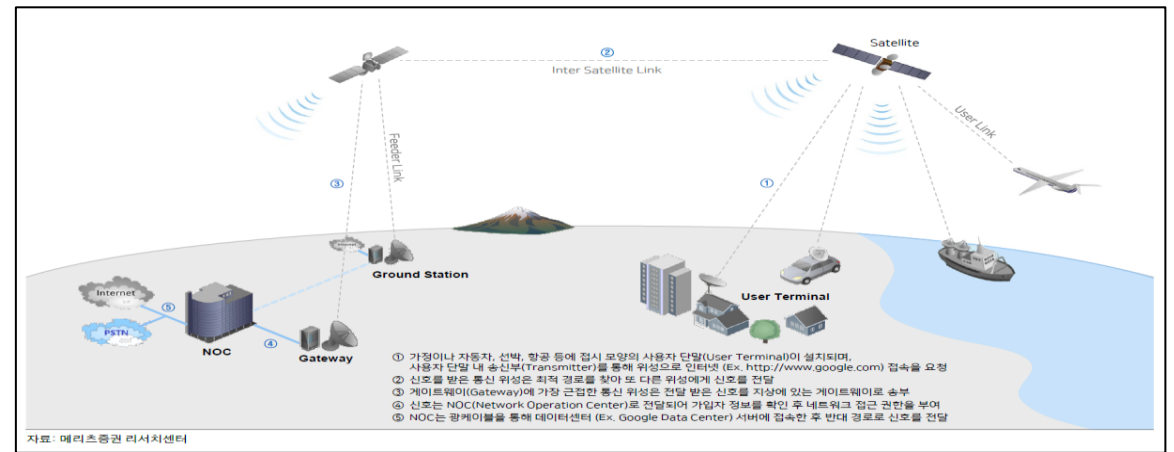
저궤도 위성 시장 전망 (단위: 십억달러)



**저궤도 위성 시장 2030년까지 연평균 성장률 11.9% 전망**

Source: Secondary Research, Interviews with Experts, MarketandMarketsAnalysis

## 글로벌 우주항공 업체향.. EMI실드 장비 핵심 공급사 → 2023년부터 3년 연속 공급 중..



**저궤도 위성통신 구조 및 프로세스**

# · 한미반도체 기업지배구조보고서 준수율 상황

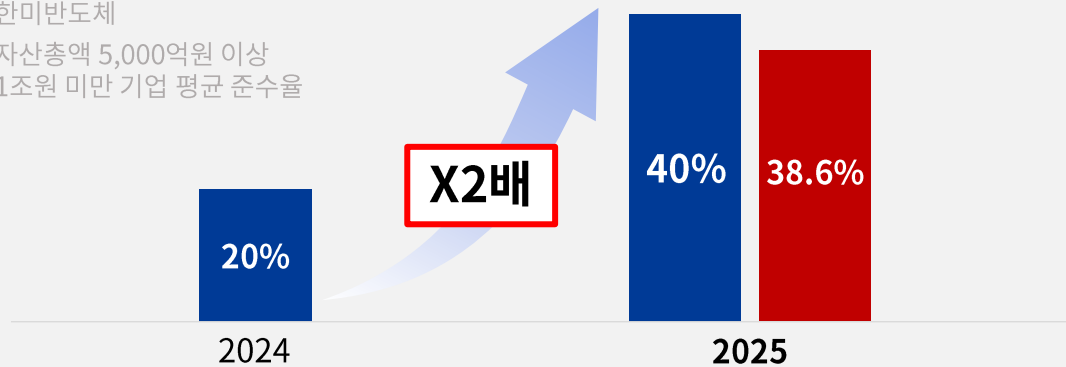
- 2026년 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율 전년 대비 2배 증가

## 기업지배구조보고서 핵심지표 이행 목표사항

구분	핵심지표	준수현황	
		FY2024	FY2025 (목표)
1	전자투표 실시	X	0
2	주주총회의 집중일 이외 개최	X	0
3	내부감사기구 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인 회의 개최	X	0

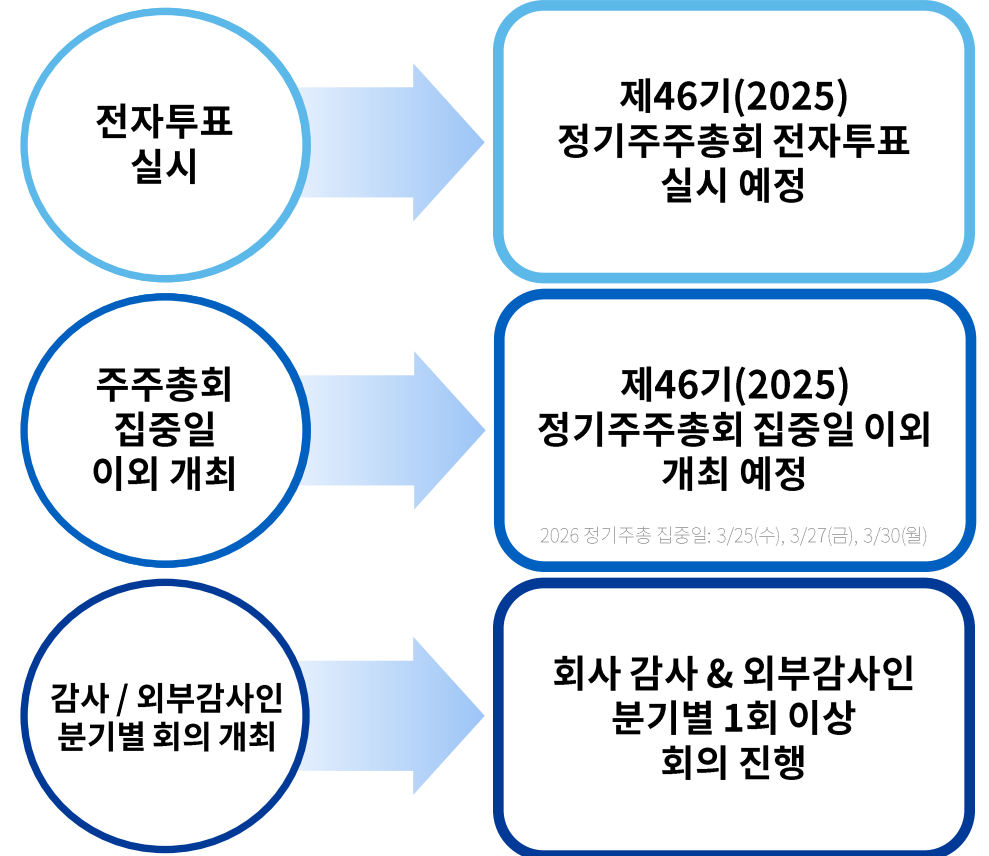
## 기업지배구조보고서 준수율 목표

■ 한미반도체  
■ 자산총액 5,000억원 이상  
1조원 미만 기업 평균 준수율



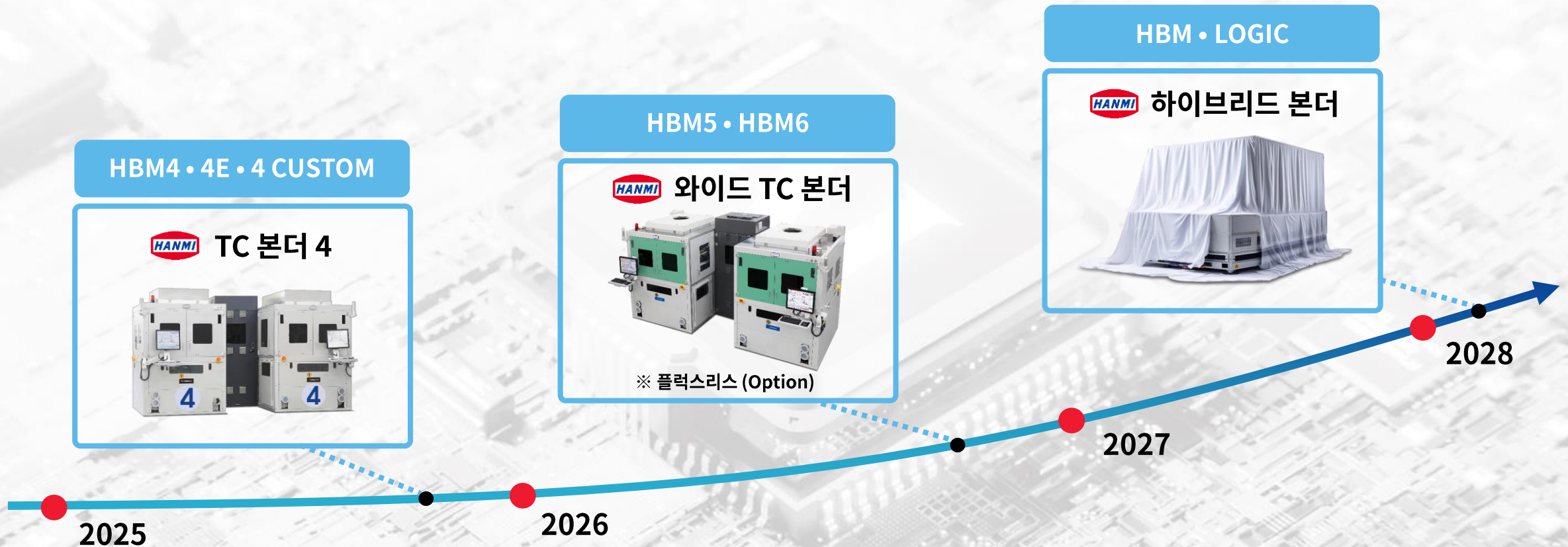
Source: 한국거래소 25년 기업지배구조 보고서 점검 및 분석 결과 발표

## 대응방안



# • 로드맵 1 - 한미반도체 HBM TC 본더

- 2025년 4월 16일, JEDEC(국제반도체표준협의기구)에서 HBM4 표준 규격을 완화 (720μm → 775μm)
- 와이드 TC 본더를 활용하여 전용 HBM 반도체(ASIC칩)를 포함한 차세대 HBM5, HBM6 반도체 생산 계획
- 높은 정밀도와 뛰어난 생산성을 바탕으로 글로벌 No.1 TC 본더 생산자로서의 입지 강화 → 진화하는 최첨단 HBM 수요에 대응

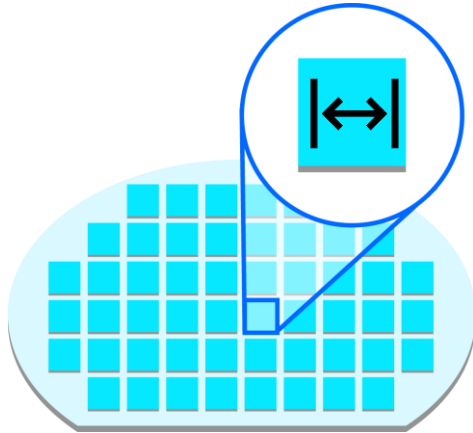


# • 로드맵 2 - 한미반도체 HBM TC 본더

- 2026년 하반기 '와이드 타입 HBM' 출시 → 차세대 '와이드 TC 본더' 출시 예정

## AI 반도체 패키지 변화

HBM4 → HBM4e → HBM 다이 크기 확대



- Die 크기를 확대한 '와이드 타입 HBM' 개발 추진
- 20단 이상 고적층 HBM 양산용 Hybrid 본더의 부재

## 변화에 따른 대응

HBM5 → HBM6 → 와이드 TC 본더



- '와이드 타입 HBM'을 생산하는 차세대 본더 → WIDE TC 본더 (WTCB)
- 플렉스리스 본딩 기능: 옵션 추가 가능

# • 하이브리드 본더 팩토리 7공장 건립

- 글로벌 메모리 업체들의 HBM5, HBM6 양산에 대응하기 위해 와이드 TC 본더 대량 생산 시스템 구축
- 차세대 HBM 생산용 본딩 장비 ‘시장 리더십’ 지속 → **Hybrid Bonder Factory 7공장 건립**



**01**

## 와이드 타입 HBM 생산용 차세대 장비 ‘와이드 TC 본더’

- I/O, TSV, 그리고 마이크로 범프 수 증가
- 기존 고적층 방식 대비 메모리대역 확대 · 열 관리 및 전력 효율 개선



**02**

## 총 1,000억원 규모 ‘Hybrid Bonder Factory’ 건설 중

- 최첨단 HBM TC본더 대량 양산을 위해 2026년 하반기 완공 예정
- 반도체 전공정 장비 제조사인 ‘테스’와 하이브리드 본더 장비 개발 협력